

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 关于调整 2025 年度利润分配方案每股分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金红利由0.6233元（含税）调整为0.62016元（含税）。

● 本次调整原因：因盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续已办理完成，归属股票数量为2,431,900股，归属完成后公司总股本由480,164,789股增加至482,596,689股。另外，公司回购专用证券账户中现存股份数量为443,400股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本为482,596,689股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量443,400股，公司实际参与分配的股份数为482,153,289股。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

#### 一、调整前利润分配方案内容

公司于2026年2月26日召开第三届董事会第三次会议，于2026年6月16日召开了2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有公司股份后的股本总额为基数进行利润分配。截至2025年12月31日，公司总股本为480,164,789股，以剔除已回购股份443,400股后的总股本为基准，拟每10股派发现金红利6.233元（含税），共计派发现金红利299,010,341.76元（含税），本次利润分配现金分红金额占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的21.42%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额50,012,340.46元，现金分红和回购金额合计349,022,682.22元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例25.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计299,010,341.76元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例21.42%。如在公司2025年度利润分配预案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

## 二、调整后利润分配方案

公司于2026年4月30日办理完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续，归属股票数量为2,431,900股，归属完成后公司总股本由480,164,789股增加至482,596,689股。具体内容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-019）。

公司回购专用证券账户中现存股份数量为443,400股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本为482,596,689股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量443,400股，公司实际参与分配的股份数为482,153,289股。

依据上述总股本变动情况，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，每股派发现金红利由0.6233元（含税）调整为0.62016元（含税）。具体计算方式如下：

1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数=299,010,341.76÷482,153,289≈0.62016元（含税，保留五位小数）。

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=0.62016×482,153,289≈299,012,183.71元（含税，保留两位小数，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派

实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司2025年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利0.62016元（含税），利润分配总额为299,012,183.71元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年7月3日